

新規有機薄膜作製技術とその展開

有機エレ材研(JOEM)

【応用物理学会M&BE分科会との共催】

《日時》 2006年9月29日(金) 1時～5時
《会場》 情報通信研究機構未来ICT研究センター

<http://www-karc.nict.go.jp/intro/access.html>

(所在地: 神戸市西区岩岡町岩岡 588-2 TEL: 078-969-2100)

《趣旨》 有機薄膜作製技術およびその評価は、有機デバイス・バイオデバイス作製のための基盤技術である。分子配向制御、薄膜作製、界面制御に関する新規な技術に関する研究会を行う。従来の技術および手法との相違点やその応用に関して議論を行う。これらの技術は基盤技術であるため様々な応用展開が考えられ、ある目的で開発した技術および評価手法が他分野で役立てられれば、更に付加価値を持たせることもできる。このような基盤技術の応用は見方によっては多分野にまたがることも考えられるため、講師の先生方には、研究の背景、基礎から応用まで詳しくお話いただきたいと考えている。

(世話人 情通機構 山田 俊樹、日本電気 東口 達)

《プログラム》 座長 情通機構 山田 俊樹

- 13:30~14:10 「有機ナノ粒子水分散液の
レーザアブレーション法による作製と薄膜化」
阪大 朝日 剛
- 14:10~14:50 「アクセサブルナノ構造テンプレートを利用した
金属ナノ粒子の組織化」
高知大 渡辺 茂
- 14:50~15:00 休憩(10分)
- 15:00~15:40 「ナノパーティクルによる有機・生体高分子の
微細パターン形成とその応用」
理研 山形 豊
- 15:40~16:20 「有機薄膜成長における基板表面ステップと
溶媒雰囲気の効果」
東大 島田 敏宏
- 16:20~17:00 補充討論・総括討論

参加費: 参加費、講演要旨集代は無料です。

会員以外は参加費(要旨集代含む)として3,000円を当日受付にて申し受けます。

懇親会費: 今回に限り懇親会はありません。

参加登録: 参加登録、登録の変更は、9月22日(金)までに、次へお願いします。

(1) Web site: <http://www.organic-electronics.or.jp/> 経由『参加登録』画面

(Yahooなどでも検索できます)

(2) FAX: 0268-21-5413 (参加証は発行しません)

※ 締め切り期日を過ぎてからの参加申し込みは要旨集を配布できない場合がございますのでご注意ください。